建構完整供應鏈 搶攻軟性顯示器商機

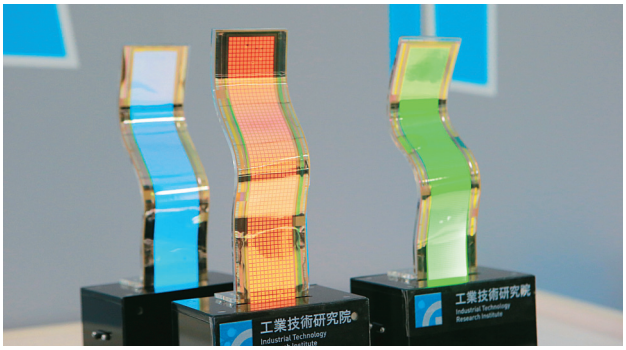
工研院與日商LINTEC結盟 共創新局

隨著智慧型手機與穿戴式裝置市場快速興起，輕、薄、耐彎曲可摺疊的軟性顯示器將帶來新一波科技產品的變革。有鑑於此，工研院宣布與日本 LINTEC 合作，期望能整合國內外產業能量，加速軟性顯示器產品問世。

整理／洪晟芝 圖片提供／工研院

工研院於日前宣布與日本琳得科先進科技（LINTEC）結盟，展開「軟性主動式有機發光二極體」（Flexible AMOLED）技術合作，共同開發軟性顯示器封裝製程的解決方案，有助於 Flexible AMOLED 朝商品化發展，力促臺灣業者搶攻軟性顯示器商機。

隨著智慧型手機與平板電腦發展進入成熟期，軟性顯示器可望帶來新一波科技產品變革。工研院影像顯示科技中心主任程章林指出，此次與 LINTEC 合作，將透過經濟部技術處法人科專建立之「Flexible AMOLED 試量產驗證平臺」，整合材料、製程與設備廠商，建構完整的軟性顯示器產業上、中、下游供應鏈，加速軟性顯示器產業發展。



工研院於日前宣布與日本琳得科先進科技（LINTEC Corporation） 結盟，展開「軟性主動式有機發光二極體」技術合作。

LINTEC 日本總部琳得科株式會社（LINTEC Corporation）是日本知名的黏、接著材料研發和生產廠商。LINTEC 提供多樣性產品，除了應用於封口、標籤、包裝封口膠帶、建築材料、汽車產品的黏著薄膜，也廣泛應用於半導體封裝，光學膜等黏著膠帶。

LINTEC 日本總部琳得科株式會社的取締役執行董事服部真表示，此次透過 LINTEC「黏著應用技術」、「材料改良技術」、「特殊紙．剝離材製造技術」、「系統化技術」等技術與工研院先進的製程技術融合，深感驕傲與榮幸。針對未來的次世代可撓曲顯示器研發，期許成為工研院的強力夥伴，全力協助先進製程技術之開發。

程章林強調，LINTEC 是工研院重要的國際研發夥伴之一，今年進一步借重 LINTEC 優異的材料技術，合作開發軟性顯示器的封裝製程，由 LINTEC 提供「溶液態高阻水阻氣層材料」與其他關鍵材料，補足臺灣產業在 Flexible AMOLED 前瞻封裝技術的材料缺口，搭配經濟部技術處法人科專研發之先進製程整合技術，期望能夠加速推動軟性顯示器產品問世。

程章林表示，希望藉由與日本 LINTEC 結盟，為國內面板產業注入能量，協助業者技術升級，增加市場利基。同時，為促進軟性顯示器產業加速成型，工研院將持續整合國內外產業能量，推動相關技術朝商品化發展。